

低温タイプ鉛フリー無電解ニッケルめっき液

トップニコロンMSH-LF

Low Bath Temperature Type, Lead-free Electroless Nickel Plating Solution

TOP NICORON MSH-LF

- 70°Cの低温で使用できるため、光熱費を削減でき、作業環境にも優しい
- 70°Cで約12 $\mu\text{m}/\text{h}$ の析出速度が得られる
- 連続使用時の析出速度が一定で、浴管理しやすい
- 皮膜の応力が低く、連続使用による応力の変動も少ない

- Use at a low bath temperature (70°C), designed as eco-friendly product to reduce fuel expenses
- Deposition rate : Approx. 12 $\mu\text{m}/\text{h}$ (70°C)
- Maintain deposition rate in continuous use, easy bath control
- The film stress of the deposit is small, small change of film stress in continuous use

作業条件 Working condition

建浴濃度 Make-up	トップニコロンMSH-SLF 200ml/L TOP NICORON MSH-SLF 200ml/L
ニッケル濃度 Nickel concentration	5.5g/L
pH	5.6
温度 Bath temperature	70°C

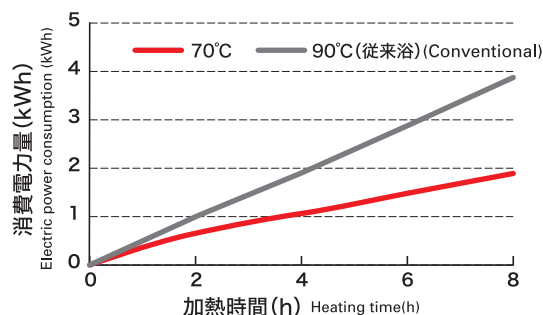
特長 Performance

■ 低温化による光熱費の削減

Use at a low bath temperature to reduce fuel expenses

加熱時間と消費電力の関係

Relationship of bath heating time and electric power consumption

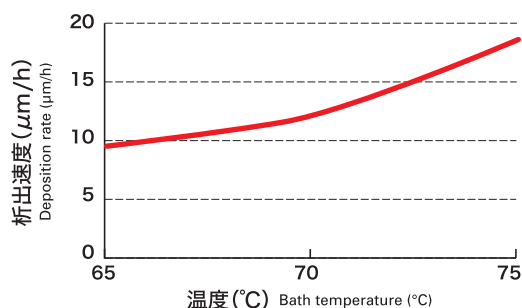


■ 低温での優れた析出速度

High deposition rate at a low bath temperature

温度と析出速度の関係

Relationship of bath temperature and deposition rate

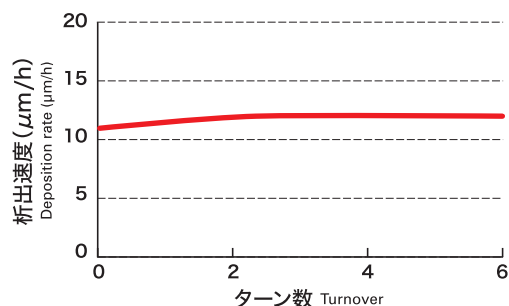


■ 連続使用時の安定した析出速度

Stable deposition rate in continuous use

ターン数と析出速度の関係

Relationship of turnover and deposition rate



■ 低い析出応力

Low stress

ターン数と析出応力の関係

Relationship of turnover and internal stress

